

液态填隙料 TIM - LGF

Silicone, Cure Type Dispensable Liquid Gap

TIM-LGF导热液态填隙料综合了固化料与“凝胶状”模量的特性而设，它可以很容易的压缩形变。这种材料有导热、绝缘和导电，单或双组份，室温或加温固化系统。这种即用型填隙料适合各种厚度并且只需少许压力或无需压力。

典型应用 Typical Applications

理想的电路板，多个可变高度封装需要一个热通道散热器或外壳。汽车电子控制单元（ECU）、电源和半导体、存储器和电源模块和光纤通信设备。

	2004	2005	2006	2007	2030	2301
类型 Type	双组份硅基 Two Parts Silicone	双组份硅基 Two Parts Silicone	双组份硅基 Two Parts Silicone	双组份硅基 Two Parts Silicone	双组份硅基 Two Parts Silicone	单组份硅基 one Parts Silicone
特征 Special Futures	高粘度，无坍塌 High Vis, No Slump	非常柔软， 凝胶型状 Very soft, Gel type cure	可塑性高,无坍塌 导热油脂/膏状 Controlled cure, No Slump Grease/Paste type cure	柔软，高导热 Soft cure, High TC	柔软，高导热 有触变 Soft cure, High TC Thixotropic	室温快速固化 密封材料 Fast Cure, RTV Sealant
颜色 Color	粉红色 Pink	灰色 Gray	蓝色 Blue	蓝色 Blue	绿色 Green	白色 White
混合后粘度 (PaS) Mixed Viscosity.	150	73	120	80	400	N/A
混合比例 Mix Ratio	1: 1	1: 1	1: 1	1: 1	1: 1	N/A
比重@25°C Specific Gravity	2.8	2.0	2.1	2.5	2.5	1.29
硬度(Shore 00) Operating Temp Range	70	<5	触变膏	45	35	35
可操作时间@25°C Pot Life	60 min	90 min	24 hrs	90 min	60 min	15 min
固化时间@25°C Cure Time	24 - 48 hrs	24 - 48 hrs	48 hrs	24 - 48 hrs	24 - 48 hrs	24 hrs
固化时间@100°C Cure Time	20 min	30 min	5min	30 min	30 min	N/A
可燃性等级 Flammability	UL 94 V-0	UL 94 V-0	UL 94 V-0	UL 94 V-0	UL 94 V-0	UL 94 V-0
可操作温度范围(°C) Operating Temp Range	-55°C to 204°C	-55°C to 204°C	-55°C to 204°C	-55°C to 204°C	-55°C to 204°C	-55°C to 260°C
保存期限(未拆封) Shelf Life (Unopened)	12 months	12 months	12 months	12 months	12 months	12 months
击穿电压(KV /mm) Breakdown Voltage	2.0	1.2	0.8	1.5	3.5	0.20
损耗因数(1KHz) Dissipation Factor	12	12	12	12	13	12
体积电阻率(Ohm-cm) Volume Resistivity	10 ¹²	10 ¹²	10 ¹²	10 ¹²	10 ¹²	10 ¹²